证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2024-002

锦州神工半导体股份有限公司 2023 年年度业绩预告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 经财务部门初步测算，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年年度实现营业收入为 13,500.00 万元到 14,500.00 万元，与上年同期相比减少 39,423.65 万元到 40,423.65 万元，同比减少 73%到 75%。

● 预计 2023 年年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-6,700.00 万元到-7,700.00 万元，同比减少 142%到 149%。

● 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,000.00 万元到-8,000.00 万元，同比减少 145%到 152%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现营业收入为 13,500.00 万元到 14,500.00 万元，与上年同期相比，将减少 39,423.65 万元到 40,423.65 万元，同比减少 73%到 75%。

2、公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,700.00 万元到-7,700.00 万元，与上年同期相比，将减少 22,514.16 万元到 23,514.16 万元，同比减少 142%到 149%。

3、公司预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,000.00 万元到-8,000.00 万元，与上年同期相比，将减少 22,473.66 万元到 23,473.66 万元，同比减少 145%到 152%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022 年度，公司实现营业收入 53,923.65 万元，归属于母公司所有者的净利润为 15,814.16 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 15,473.66 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司 2023 年业绩较去年同期下滑，由盈转亏，主要原因是：

（一）本报告期内，受行业周期影响，公司大直径硅材料业务收入较上年大幅下降，产能利用率下滑，导致公司整体净利润较上年大幅下滑；

（二）目前公司硅零部件和硅片业务正处在市场开拓期，但其收入和利润增长规模和速度有限；同时，本报告期内计提了存货跌价准备，也导致了公司净利润的下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2024-004

锦州神工半导体股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 1 月 29 日通过现场的方式召开。会议已于 2024 年 1 月 22 日通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司监事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2024-003

锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 1 月 22 日送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2024-005

锦州神工半导体股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）发表了核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2020[100]号）核准，公司采用战略配售、网上网下方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 21.67 元。截至 2020 年 2 月 17 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额 866,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 76,049,433.93 元后的 790,750,566.07 元已于 2020 年 2 月 17 日分别存入公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行 0708004329200067771 账户 300,000,000.00 元，存入锦州银行股份有限公司金凌支行 410100692121518 账户 300,000,000.00 元，存入在锦州农村商业银行股份有限公司营业部 392212010160740453 账户 190,750,566.07 元；减除审计费、律师费、信息披露等发行费用 15,881,132.08 元后，实际募集资金净额为人民币 774,869,433.99 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第 1-00010 文号的验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 2 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为 774,869,433.99 元，小于《锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 110,200.22 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募资资金
1	8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目	86,923.41	60,000.00
2	研发中心建设项目	23,276.81	17,486.94
合计		110,200.22	77,486.94

公司于 2021 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将募投项目“8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”的预定可使用状态日期调整至 2023 年 2 月，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-053）。

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将募投项目“8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”的预定可使用状态日期调整至 2024 年 2 月，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-007）。

截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金的使用情况详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”已于 2024 年 1 月达到预定可使用状态，项目开发的 8 英寸半导体级硅单晶抛光片等产品已实现打通产线，目前部分产品已通过客户认证并实现小批量供货。截至本公告披露之日，公司“8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额（A）	累计投入募集资金总额（B）	投入比例（C=B/A）	利息收益扣除手续费后的净额（D）	预计节余募集资金金额（E=A-B+D）
8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目	60,000.00	55,780.20	92.97%	4,826.82	9,046.62

注：1、“预计节余募集资金金额”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入，实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准；

2、“利息收益扣除手续费后的净额”系指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。

四、本次结项项目募集资金节余的主要原因

1、公司于募投项目建设过程中严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。

2、在募投项目建设过程中，公司根据募投项目建设进度合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下有效提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、在本次结项的募投项目实施过程中，公司根据项目规划并结合实际情况，通过优化项目场地规划设计、减少部分配套建筑面积、优化设备采购方案等，有效降低项目建设工程费用；同时，公司在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，进一步降低了项目建设成本。

4、该项目存在尚未支付的尾款及质保金，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致，从而现阶段形成一定节余。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定支付。

五、节余募集资金的使用计划

自首次公开发行股票并上市以来，公司持续加强对现有产品的完善与升级以及对新产品和新技术的研究与开发，研发投入占营业收入的比例逐年提升。截至 2024 年 1 月，公司“8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。随着公司业务规模的扩张，为进一步提高募集资金使用效率，提高企业经济效益并降低财务费用，公司拟将前述项目结项后的节余募集资金 9,046.62 万元永久补充流动资金（含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。节余募集资金（含利息收益）转出完成后，公司将注销设立在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行和锦州银行股份有限公司金凌支行的募集资金专户，公司与中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行和锦州银行股份有限公司金凌支行以及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

六、审议程序和专项意见

（一）董事会审议情况

2024 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准对首次公开发行募投项目之“8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

（三）监事会审议情况

2024 年 1 月 29 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，其决策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构国泰君安认为：

公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2024-006
债券代码：113063　　债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 2023 年年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。

● 预计 2023 年年度实现营业收入 260 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 40.98 亿元左右，同比增加 18.71%左右。

● 预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 31 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 17.68 亿元左右，同比增加 132.77%左右。

● 预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31.60 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 18.25 亿元左右，同比增加 136.71%左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现营业收入 260 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 40.98 亿元左右，同比增加 18.71%左右。

预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 31 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 17.68 亿元左右，同比增加 132.77%左右。

预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31.60 亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 18.25 亿元左右，同比增加 136.71%左右。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：13.32 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13.35 亿元。

（二）每股收益：0.44 元。

三、本期业绩预增的主要原因

2023 年，国内轮胎市场需求恢复明显，国外经销商去库存对公司生产经营的影响也在下半年逐步消除。随着公司产能释放及产能利用率的不断提升，公司全钢胎、半钢胎和非公路轮胎的产销量均创历史新高，产品毛利率同比也有较大幅度增长。公司紧紧围绕“做一条好轮胎”的使命，长期坚持在非公路轮胎领域进行研发投入及技术创新，矿卡胎、农业胎及巨胎等产品性能获得了越来越多客户的认可，本期收入增幅和毛利率水平均高于全钢胎和半钢胎。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。目前本公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：601058　　证券简称：赛轮轮胎　　公告编号：临 2024-005
债券代码：113063　　债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 关于全资子公司追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：柬埔寨年产 1,200 万条半钢子午线轮胎项目

● 投资金额：224,722 万元，其中：建设投资 188,360 万元、流动资金 34,667 万元、建设期利息 1,695 万元。

● 特别风险提示：

1、未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

一、追加投资概述

2023 年 10 月 27 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司通过境外全资子公司在柬埔寨设立的全资公司 CART TIRE CO.,LTD.（以下简称“CART TIRE”）具体实施“柬埔寨年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”，项目投资总额 147,353 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设“柬埔寨年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”的公告》（公告编号：临 2023-099）。

公司于 2024 年 1 月 29 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 4 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于全资子公司追加投资的议案》，该项议案同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意对“柬埔寨投资建设年产 600 万条半钢子午线轮胎项目”追加投资 77,369 万元，追加投资后项目投资总额为 224,722 万元，项目将具备年产 1,200 万条半钢子午线轮胎的生产能力。

本次追加投资相关事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，该事项在董事会审议额度范围内，无须提交股东大会审议。

二、项目基本情况

1、项目名称：柬埔寨年产 1,200 万条半钢子午线轮胎项目

2、项目实施主体：CART TIRE

3、项目实施地点：柬埔寨柴桢省柴桢市

4、项目建设进度：项目建设期 16 个月

5、项目总投资：项目投资总额 224,722 万元，其中：建设投资 188,360 万元、流动资金 34,667 万元、建设期利息 1,695 万元。本项目所需资金将由 CART TIRE 的自有资金及自筹资金解决。

6、经济效益：本项目预计实现年平均营业收入 323,238 万元，实现年平均净利润 70,052 万元。根据财务分析评价结果，项目净利润率为 21.67%，项目投资回收期为 4.38 年。

7、市场定位：北美等海外市场。

8、项目审批及备案情况：项目尚需国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案。

三、项目建设主体的基本情况

（一）公司概况

1、公司名称：CART TIRE CO.,LTD.

2、公司类型：有限责任公司

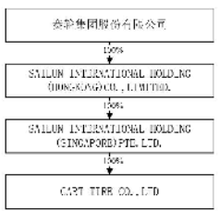
3、注册地：柬埔寨柴桢省柴桢市一号路齐鲁柬埔寨经济特区

4、注册编号：1000047387

5、注册资本：17,000 万美元（增资至 26,900 万美元的手续尚在办理中）

6、公司董事：姜仁双

7、股权结构：



四、追加投资对公司的影响

公司在柬埔寨拥有丰富的建设及运营经验，本次年产 1,200 万条半钢子午线轮胎项目建设完成后，CART TIRE 将具备年产 2,100 万条半钢子午线轮胎及 165 万条全钢子午线轮胎的生产能力，可以更好的满足海外市场的需求，并进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意义。有利于提升公司产品销量、营业收入及利润，提高上市公司的综合竞争力。

五、风险提示

未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

本投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议

2、《赛轮集团股份有限公司柬埔寨年产 1,200 万条半钢子午线轮胎项目可行性研究报告》

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：605020　　证券简称：永和股份　　公告编号：2024-008
债券代码：111007　　债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称“邵武永和”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司邵武永和提供最高额为 5,000.00 万元的连带责任保证担保，截至本公告日，公司已实际为邵武永和提供的担保余额为 33,161.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司均无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024 年 1 月 26 日，公司与招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为邵武永和与招商银行签订的《授信协议》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为 5,000.00 万元。本次担保事项不存在反担保情况。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议、2022 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》，同意公司及子公司共同或单独为合并报表范围内子公司提供最高不超过 153,000.00 万元的融资担保额度，其中为全资子公司邵武永和提供的担保额度为不超过 73,000 万元。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的公告》（公告编号：2023-027）。

2023 年 8 月 11 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调剂公司向银行申请综合授信额度及在控股子公司之间调剂担保额度的议案》，同意将内蒙永和未使用担保额度中的 5,000 万元调剂至邵武永和，公司为邵武永和提供的担保额度由 73,000 万元增加至 78,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调剂公司向银行申请综合授信额度及在控股子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2023-093）。

本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：邵武永和金塘新材料有限公司

成立时间：2017 年 12 月 27 日

法定代表人：谢东颖

统一社会信用代码：91350781MA31E0EJ4X

注册资本：115,832.06 万元人民币

注册地址：福建省邵武市金塘工业园

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；特种设备销售；机械设备销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司的关系：公司直接持股 100%，为公司全资子公司。

最近一年及一期主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），邵武永和资产总额 158,053.36 万元，负债总额 61,500.80 万元，净资产 96,552.56 万元，资产负债率为 38.91%；2022 年实现营业收入 17,988.79 万元，净利润-1,911.37 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），邵武永和资产总额 205,991.00 万元，负债总额 100,681.25 万元，净资产 105,309.75 万元，资产负债率为 48.88%；2023 年 1-9 月实现营业收入 54,939.95 万元，净利润-4,537.24 万元。

三、协议的主要内容

保证人：浙江永和制冷股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司福州分行

债务人：邵武永和金塘新材料有限公司

担保额度：人民币 5,000.00 万元

保证方式：连带保证责任

保证范围：主协议项下全部债务以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保时间：自担保书生效之日至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任何一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

2023 年 4 月 3 日公司召开第三届董事会第三十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》并同意提交公司股东大会审议。

董事会认为本次担保事项是公司为了满足子公司生产经营及项目建设资金需要而提供的担保，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额（均为公司对全资子公司的担保）为 44,867.70 万元，占公司最近一期经审计净资产 17.87%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

证券代码：601963　　证券简称：重庆银行　　公告编号：2024-006
可转债代码：113056　　可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）上市地上市规则的要求，本行制定了《重庆银行股份有限公司 A 股发行后三年内稳定公司 A 股股价的预案》（以下简称“《稳定股价预案》”），该《稳定股价预案》于 2016 年 6 月 17 日经本行 2015 年度股东周年大会及类别股东会议审议通过。本行根据监管要求和本行实际情况，对《稳定股价预案》进行了修订，并于 2019 年 5 月 24 日经本行 2018 年度股东周年大会及类别股东会议审议通过。《稳定股价预案》具体内容详见《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》。

根据《稳定股价预案》，本行 A 股发行后三年内，如非因不可抗力因素所致本行 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本行净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在满足法律、法规和规范性文件关于增持或回购相关规定的情形下，本行及相关主体将根据该预案采取措施稳定本行股价。

本行最近一期经审计的每股净资产为 12.90 元，因实施 2022 年年度权益分派，最近一期经审计的每股净资产经除息后相应调整为 12.505 元。自 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 29 日，本行 A 股股票已连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产，达到触发稳定股价措施的启动条件。

根据《稳定股价预案》，本行董事会将在本行股票价格触发启动稳定股价措施条件之日（2024 年 1 月 29 日）起的 10 个交易日内制订本行稳定股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2024 年 1 月 29 日

证券代码：601963　　证券简称：重庆银行　　公告编号：2024-007
可转债代码：113056　　可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 605,158,430 股。

本次股票上市流通总数为 605,158,430 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 5 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3511 号）核准，本行向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 347,450,534 股，并于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。

首次公开发行股票后，本行总股本为 3,474,505,339 股，其中：有限售条件 A 股股份为 1,548,033,993 股，无限售条件 A 股股份为 347,450,534 股，H 股股份为 1,579,020,812 股。截至 2024 年 1 月 28 日，本行总股本为 3,474,562,309 股，其中：有限售条件 A 股股份为 1,204,126,450 股，无限售条件 A 股股份为 691,415,047 股，H 股股份为 1,579,020,812 股。

本次上市流通的限售股为本行首次公开发行 A 股限售股，共计 605,158,430 股，涉及 314 名股东，锁定期为自本行股票上市之日起 36 个月，该部分限售股将于 2024 年 2 月 5 日（周一）锁定期届满，并于当日上市流通。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

本行于 2022 年 3 月 23 日公开发行 130 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“重银转债”），截至 2024 年 1 月 28 日，累计已有人民币 621,000 元重银转债转为本行 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 56,970 股，本行总股本由 3,474,505,339 股增加为 3,474,562,309 股。

本次限售股形成后至今，除上述情形外，本行未发生配股、公积金转增股本等导致本行股本数量发生变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股股东所持有的股份流通限制如下：

（一）重庆市水利投资（集团）有限公司、重庆市地产集团有限公司、力帆实业（集团）股份有限公司（已更名为力帆科技（集团）股份有限公司）、北大方正集团有限公司（所持股份已划转至新方正控股发展有限责任公司）、重庆发展置业管理有限公司、重庆高速公路投资控股有限公司、民生实业（集团）有限公司等公司承诺：

“自重庆银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的重庆银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由重庆银行回购本公司持有的重庆银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。锁定期届满后将按有关监管机构的相关规定执行。”

（二）持有本行股份的时任监事承诺：

“1、本人将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定。

2、自重庆银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的重庆银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由重庆银行回购本人持有的重庆银行首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。

3、在上述承诺的锁定期届满后，本人还将依法及时向重庆银行申报所持有的重庆银行股份及其变动